

2024年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2024) セッションプログラム

【第1日目: 8月26日(月)】

	A室	B室	C室	D室	アリーナ
9:00					
9:20					
9:40					
10:00					
10:20	D. 研削現象の基礎とモニタリング(1)	J. 環境調和型加工技術(1)	R. 光・ビームによる加工技術(1)	W. 先端半導体材料の精密加工(1)	
10:40					
11:00					
11:20					
11:40	D. 研削現象の基礎とモニタリング(2)	J. 環境調和型加工技術(2)	R. 光・ビームによる加工技術(2)	W. 先端半導体材料の精密加工(2)	
12:00					
12:20					
12:40					
13:00					パネル・カタログ展示
13:20					
13:40	D. 研削現象の基礎とモニタリング(3)	A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(1)	G. マイクロ・ナノ加工(1)	F. プラスト・バレル加工の最前線	
14:00					
14:20					
14:40					
15:00					
15:20					
15:40	D. 研削現象の基礎とモニタリング(4)	A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(2)	G. マイクロ・ナノ加工(2)	S. 医歯工学	
16:00					
16:20					
16:40					
17:10	学会活性化フォーラム(A室) ／交流会(B～C室)				
20:00					

【第2日目: 8月27日(火)】

	A室	B室	C室	D室	アリーナ
9:00					
9:20					
9:40	M. 高性能切削工具の開発と応用	A. ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(3)	B. 先端加工計測技術(1)	N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM	
10:00					
10:20					
10:40					
11:00					一般セッション
11:20	E. ナノ精密・ELID加工	C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用	B. 先端加工計測技術(2)	P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術	
11:40					
12:00					
12:20					
12:40					
13:00	我が社の新技術発表会 (A～D室)				パネル・カタログ展示
13:20					
13:40					
14:00					
14:50					
16:20					
16:30					
17:30					
18:00					
20:00					

【第3日目: 8月28日(水)】

	A室	B室	C室	D室	アリーナ
9:00					
9:20	L. 切断・切断加工	I. 超音波・振動援用加工(1)	T. 付加工	X. 表面改質技術(1)	
9:40					
10:00					
10:20					
10:40					
11:00	Q. 磁界・電界磁粒制御による次世代加工技術	I. 超音波・振動援用加工(2)	K. 難削材・新素材の加工と応用	X. 表面改質技術(2)	
11:20					
11:40					
12:00					パネル・カタログ展示
12:20					
12:40					
13:00	奨励賞受賞記念講演 (A室)				
13:20					
13:40					
14:00					
14:20		I. 超音波・振動援用加工(3)	V. トライボロジー	X. 表面改質技術(3)	
14:40	O. 加工のデータサイエンス				
15:00					
15:20					
15:40		I. 超音波・振動援用加工(4)		H. 先進切削加工技術	
16:00					
16:20					
16:40					

2024年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2024)セッションプログラム

【第1日目:8月26日(月)】(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	
	<p>[D. 研削現象の基礎とモニタリング(1)] (大橋 一仁, 山田 高三, 吉原 信人, 藤本 正和) 座長 大橋 一仁(岡山大学)</p>	<p>[J. 環境調和型加工技術(1)] (岩井 学, ニノ宮 進一, 佐藤 運海, 西川 尚宏) 座長 岩井 学(富山県立大学)</p>	<p>[R. 光・ビームによる加工技術(1)] (比田井 洋史, 細野 高史, 池野 順一, 江面 篤志, 山田 洋) 座長 山田 洋平(埼玉大学)</p>	<p>[W. 先端半導体材料の精密加工(1)] (黒河 周平, 加藤 智久) 座長 黒河 周平(九州大学)</p>	
10:00	A01 研削・琢磨機におけるポリシング状態のAEセンシング ○長谷並剛(埼玉工業大学, 理化学研究所), 宮岡秀治(プロテリアル)	B01 AlN基板の表面に及ぼすNa ₂ SO ₄ 電解水の影響 ○佐藤運海(信州大学), 馬場隆光(ニッソー), 川久保英樹(信州大学)	C01 ダイヤモンド工具を用いたバインダレス超硬合金のレーザー援用微細切削加工に関する研究 ○何一聞, 由井明紀(神奈川大学)	D01 GaN基板の粗研削加工により導入される加工変質層の評価 ○石橋恵人(長岡技術科学大学), 大宮泰津子(三桜工業), 武田秀俊(長岡技術科学大学), 阿波秀平(三桜工業), 曾田英雄(長岡技術科学大学)	10:00
10:20	A02 研削時AE信号周波数特性のクラスター解析による研削不良監視プロセスに関する検討 ○許 刘滨子, 趙璐瑾, 田中秀明(湘南工科大学)	B02 水溶性加工液の濃度測定に関する研究(第2報) ○山口顕司(米子工業高専), 坂本智(横浜国立大学)	C02 ガラス基板のレーザー切断加工のための初期欠陥のCO ₂ レーザーによる導入 一欠陥導入の基礎的研究一 ○楊舒雯, 程子雄, 岡工太郎, 半田貴之, 山田啓司, 田中隆太郎, 関谷克彦(広島大学)	D02 UV照射アシストによるGaN基板の研磨の評価 ○小菅春毅, 松井伸介, 貴名広樹(千葉工業大学), 三井貴彦, 嶋田貴大(岡本工作機械製作所), 矢島利康, 二宮大輔, 瀬原大(丸石産業)	10:20
10:40	A03 平面研削における表面粗さの予測とテクスチャ解析 ○市原浩一(住友重機械工業)	B03 工作機械用の防振ミストコレクタ制御のための機内視程モニタ ○山本幸佑, 小菅正裕, 野呂俊太(DMG森精機), 廣埴俊樹, 中川正夫(同志社大学)	C03 超短パルスレーザーによるステンレス箔のLIPSS形成 一箔厚およびレーザー照射条件が反りに及ぼす影響一 ○大橋尊(三奈市立大学), 笹崎大生, 柚直彦(ワイヤード), 江面篤志(三奈市立大学)	D03 光電気化学反応援用型触媒表面基準エッチング法による結晶不均一性を有するGaN(0001)基板の高効率平滑化加工 ○菅尾澄人, 深川達哉, 藤本大, 山田純平, 山内和人, 佐野泰久(大阪大学)	10:40
11:00	<p>[D. 研削現象の基礎とモニタリング(2)] (大橋 一仁, 山田 高三, 吉原 信人, 藤本 正和) 座長 山田 高三(日本大学)</p>	<p>[J. 環境調和型加工技術(2)] (岩井 学, ニノ宮 進一, 佐藤 運海, 西川 尚宏) 座長 佐藤 運海(信州大学)</p>	<p>[R. 光・ビームによる加工技術(2)] (比田井 洋史, 細野 高史, 池野 順一, 江面 篤志, 山田 洋) 座長 江面 篤志(三奈市立大学)</p>	<p>[W. 先端半導体材料の精密加工(2)] (黒河 周平, 加藤 智久) 座長 黒河 周平(九州大学)</p>	
11:20	A05 ティーパーニングを用いた机上計測による砥石作業面の解析(第7報) - 深層生成モデルによる砥面画像補正と研削過程での砥面予測 - ○川下智幸, 坂口彰浩, 松尾修二(佐世保工業高専), 松本竜宙(佐世保工業高専 現:旭化成), 樋口開斗(佐世保工業高専 現:SUBARU), 原喜人, 井村諒介, 山崎崇義, 板津武志, 長瀬幸泰(ナガセインテグレックス)	B05 低圧サイクロンセパレータによる液中アルミ粉の回収特性 ○佐藤克彦, 入澤勇人(ニクニ), 李牧之, ニノ宮進一(日本工業大学)	C05 高出力レーザーを用いた加工装置の開発及び性能評価 ○赤間洗太, 菅原颯斗, 浅沼昇輔, 佐藤慎之助, 松浦寛(東北学院大学)	D05 機能性砥粒を用いたSiO ₂ /エハのフィルム式エッジ研磨加工 ○大橋達也, 山口直宏, 多田勲起, 矢内一馬(Mipox), 加藤智久(産業技術総合研究所)	11:20
11:40	A06 ティーパーニングを用いた机上計測による砥石作業面の解析(第8報) - 深層生成モデルによる3次元形状データの画像生成 - ○坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二(佐世保工業高専), 松本竜宙(佐世保工業高専 現:旭化成(株)), 樋口開斗(佐世保工業高専 現:(株)SUBARU), 原喜人, 井村諒介, 山崎崇義, 板津武志, 長瀬幸泰(ナガセインテグレックス)	B06 ウルトラファインパブルクラントの冷却能に関する研究 第2報:電熱線加熱による液の熱伝達特性 ○李牧之, ニノ宮進一(日本工業大学), 野村哲雄(ノデバイス), 岩井学(富山県立大学)	C06 ピコ秒パルスレーザーを使った3次元微細形状に対する焦点加工 ○仙波卓弥, 天本祥文, 三浦太久真(福岡工業大学)	D06 第一原理分子動力学計算によるSiC-H ₂ O水溶液界面の反応解析 ○森下徹也, 栢沼愛, 加藤智久(産業技術総合研究所)	11:40
12:00	A07 PIV法を用いた円盤(砥石)周りの空気流れの可視化 ○桑田留伊, 川島久宜, 天谷賢児, 林偉民(群馬大学)	B07 電気防錆加工法の研究開発 ○西川尚宏(岩手大学)	C07 短パルスレーザーを使った3次元微細形状に対する高速加工技術 ○天本祥文, 仙波卓弥, 三浦太久真(福岡工業大学)	D07 ウォータガイドレーザー(WGL)を利用したSiCウエハ加工特性 ○平野舜也, 田端真樹, 金赫(牧野フライス製作所), 加藤智久(産業技術総合研究所)	12:00
12:20	***** 休憩 *****				12:20

	[D. 研削現象の基礎とモニタリング(3)] (大橋 一仁, 山田 高三, 吉原 信人, 藤本 正和) 座長 藤本 正和(足利大学)	[A. ラッピング・ポリシング・CMPの原理と応用(1)] (林 偉民, 鈴木 恵友, 佐竹 うらら, 村田 順二) 座長 林 偉民(群馬大学)	[G. マイクロ・ナノ加工(1)] (松井 伸介, 松村 隆, 江頭 快, 天本 祥文) 座長 松村 隆(東京電機大学)	[F. プラスト・バレル加工の最新動向] (嶋田 慶太, 南部 紘一郎, 宮島 敏郎) 座長 嶋田 慶太(日本大学)		
13:00	A11 顕微ラマン分光法を用いたダイヤモンド砥粒特性の統計的分析における解析手法および条件の検討 ○笹倉大督, 早内愛子(スペクトリス), 芝原健斗, 菊田勝文, 小杉剛(グローバルダイヤモンド)	B11 強磁石を用いた新機構研磨装置の開発 —デッドウェイト方式との比較— ○和田竜之, 畝田道雄, 十河 憲夫(金沢工業大学), 宮下忠一, 金井洋介(不二越機械工業), 石川憲一(金沢工業大学)	C11 鋼のMSE特性に及ぼすアルミナ砥粒径および投射条件の影響 ○王建, 西岡岳(福井工業大学), 安田穂積, 和田雄高, 榎山浩園(荏原製作所)	D11 A6061アルミニウム合金の疲労強度に及ぼすショットピーニング条件の影響 ○近藤凌丞, 武末翔吾, 森田辰郎(京都工芸繊維大学)	13:00	
13:20	A12 ダイヤモンド微粒子における統計的ラマン分光法を用いた強度評価に関する基礎的検討 第2報 ○芝原健斗, 小杉剛, 菊田勝文(グローバルダイヤモンド), 笹倉大督, 早内愛子(スペクトリス)	B12 モデルベースに基づくロボット研磨システムの開発に関する基礎研究 ○十権康太郎(金沢工業大学), 山本隆将(山本金属製作所), 畝田道雄, 十河憲夫(金沢工業大学), 鈴木教和(中央大学)	C12 高分子電解質膜を用いた固相電気分解によるAuのマイクロ酸化膜パターン形成 ○藤井達也, 辻淳喜, 村田順二(立命館大学)	D12 バレル研磨によるSCM440鋼の疲労強度向上 ○岸田竜也, 武末翔吾, 森田辰郎(京都工芸繊維大学), 橋本洋平, 古賀紀光(金沢大学)	13:20	
13:40	A13 ハイレンプロ研削に関する研究 ○吉原信人, 狩野弘匡, 水野雅裕(岩手大学)	B13 樹脂材料のCMPにおける研磨界面の可視化の研究 ○松永拓樹, 畝田道雄, 十河憲夫(金沢工業大学), 石田博之, 堀田和利, 森永均(フジインコーポレーテッド)	C13 固体高分子電解質膜/陽極界面の固相陽極溶解を利用した鉄系材料の微細パターン形成 ○橋本佳奈, 辻淳喜, 村田順二(立命館大学)	D13 微粒子ピーニング処理における粒子衝突時の応力分布におよぼす角速度の影響 ○南部 紘一郎(大阪産業大学), 亀山雄高(東京都市大学)	13:40	
14:00	A14 単結晶シリコンの超仕上げに用いるダイヤモンド砥石の目直しの安定化 ○山中晴喜, 古城直道, 山口智実, 廣岡大祐(関西大学), 角田勝俊, 棚田憲一(ミズホ)	B14 交互加工型プラズマCMP装置の開発とSiC基板の加工特性評価 ○宮川千宏(不二越機械工業), 澤山悠斗(不二越機械工業, 長岡技術科学大学), 和田昌樹(不二越機械工業), 土肥俊郎(Doi Laboratory), 川崎敏之, 有田潔(西日本工業大学), 武田秀俊, 會田英雄(長岡技術科学大学)	C14 cBN製インサートチップのプリハードン鋼に対する超精密切削への応用 ○仙波卓弥, 天本祥文(福岡工業大学)	D14 微粒子ピーニングによる移着に及ぼす粒子・母材間の冶金学的親和性の影響 ○奥田真司, 佐藤秀明, 小玉脩平, 亀山雄高(東京都市大学)	14:00	
14:20	A15 立形ロータリドレッシングによる超砥粒砥石のドレッシングに関する研究(第一報) —砥石表面への砥粒干渉機構の理論的解析— ○中内亮太(岡山大学), 太田恵三(黒鐵), 東江真一(ものつくり大学), 児玉敏幸, 大橋一仁(岡山大学)	B15 交互加工型プラズマCMPにおけるプラズマ照射条件の最適化 ○澤山悠斗(長岡技術科学大学, 不二越機械工業), 宮川千宏, 和田昌樹(不二越機械工業), 土肥俊郎(Doi Laboratory), 川崎敏之, 有田潔(西日本工業大学), 武田秀俊, 會田英雄(長岡技術科学大学)	C15 AFMスクラッチによる研磨加工特性の評価 ○松井伸介, 竹内夢翔, 鳥居博典(千葉工業大学)	D15 投射粒子の窒化温度が微粒子ピーニングによるチタン合金の常温窒化挙動に及ぼす影響 ○立ヶ谷龍一(静岡大学), 稲垣秀治, 鈴木良規, 佐藤夕紀子(小山鋼材), 菊池将一(静岡大学)	14:20	
14:40	[D. 研削現象の基礎とモニタリング(4)] (大橋 一仁, 山田 高三, 吉原 信人, 藤本 正和) 座長 吉原 信人(岩手大学)	[A. ラッピング・ポリシング・CMPの原理と応用(2)] (林 偉民, 鈴木 恵友, 佐竹 うらら, 村田 順二) 座長 今井 健太郎(群馬大学)	[G. マイクロ・ナノ加工(2)] (松井 伸介, 松村 隆, 江頭 快, 天本 祥文) 座長 松井 伸介(千葉工業大学)	[S. 医学工学] (佐藤 秀明, 亀山 雄高, 久慈 千栄子) 座長 久慈 千栄子(東北大学)	14:40	
15:00	A17 希薄クーラントへの微細粒子添加による動摩擦低減 平木謙儒, ○石住隆太(九州工業大学), 渡辺剛, 原悠貴, 出原暢之(日本タンクステン), 谷口茂, 山田晶子, 矢上了一(北九州工業高等)	B17 高いレーザー損傷耐性を持つYAGセラミクス表面の創生 ○吉田祐介, 萱尾澄人, 藤大智, 山田純平, 山内和人, 佐野泰久(大阪大学)	C17 微小径ボールエンドミル切削における工具姿勢が被削面の材質に及ぼす影響 ○内山文宏(内山刃物), Bouts Bonhomme Juan, 田村昌一, 松村隆(東京電機大学)	D17 微粒子ピーニングによるハイドロキシアパタイト移着膜創製に及ぼす粒子の複合化の効果 ○亀山雄高, 小野峻, 角田龍星(東京都市大学), 片平和俊(理化学研究所)	15:00	
15:20	A18 砥石の接触剛性の違いによるびり振動の発生予測 ○武井佑樹, 内田元, 山田高三(日本大学)	B18 CMG加工装置の開発と性能評価 ○足達拓光, 南條健人, 木村亮馬, 浦清寛(東北学院大学)	C18 ダイレス打抜きによる微細穴あけ加工におけるパンチ形状の改善 ○上野貴大, 橋田桂一, 江頭快(京都工芸繊維大学)	D18 結合剤の強度向上を目的としたセラチン添加型アルギン酸ナトリウムポンド軸付き砥石 ○田上海, 佐藤秀明, 亀山雄高, 小玉脩平(東京都市大学), 小正裕, 小正聡(大阪歯科大学)	15:20	
15:40	A19 円筒研削盤の工作物支持剛性の違いが加工精度に及ぼす影響 ○関優駿, 内田元, 山田高三(日本大学)	B19 ダイヤモンド半導体の実現を目指した乾式真空研磨法の開発 ○坂本武司, 篠崎烈(有明工業高等)	C19 単純円柱形マイクロ工具を用いた切削・研削複合加工による極小径軸加工 ○山中拓真, 福山敦也, 江頭快(京都工芸繊維大学)	D19 寒天粒子による軟質包装材の新たな清掃方法の開発 ○原川二千翔, 佐藤秀明(東京都市大学), 三宅晃子(大阪歯科大学), 亀山雄高, 小玉脩平(東京都市大学), 小正聡(大阪歯科大学)	15:40	
16:00	A20 高速 X 線イメージングを用いた研削プロセスのその場観察 ○王超, 廖一夫, 任浩南, 劉佳慧, 木崎通, 本山央人, 江川悟(東京大学), 山口豪太(理化学研究所), 三村秀和(東京大学, 理化学研究所), 長藤圭介, 杉田直彦(東京大学)	B20 固体高分子電解質を利用したSiCの電解酸化援用研磨における砥粒の最適 ○巴波福也, 美濃羽正士, 村田順二(立命館大学)	C20 酸化亜鉛による貼付型疲労センサの開発 ○河野竜也, 榎谷和義(東海大学)	D20 光触媒性材料のピーニングによる抗菌性を経時的に付与できる義歯床の作成 ○小正聡(大阪歯科大学), 佐藤秀明, 亀山雄高(東京都市大学), 田代悠一郎, 内藤達志(大阪歯科大学)	16:00	
16:20	A21 BGテープのヤング率がSi ₃ N ₄ のロータリ研削におよぼす影響の基礎的検討 ○楠山純平(千葉工業大学), 鈴木匠大(神奈川大学), 立山耕平(室蘭工業大学), 金澤雅喜, 石川一政, 五十嵐健二, 川瀬美真(東京精密), 中尾陽一(神奈川大学)	B21 両面研磨における加工物の厚みによる上下各面の研磨量の違いに関する検討 ○柴崎竜輝, 橋本洋平, 古本達明, 小谷野智広, 山口貢(金沢大学)		D21 微粒子ピーニングを施したチタン基板上での細胞種による細胞挙動の違い ○上田彩乃, 前間亜嶺, 亀山雄高, 桃沢愛(東京都市大学)	16:20	
16:40	***** 休憩 *****					16:40
17:10	学会活性化フォーラム(A室) / 交流会(B~C室)					17:10
20:00						20:00

2024年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2024)セッションプログラム

【第2日目:8月27日(火)】(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	
	<p>【M. 高性能切削工具の開発と応用】 (村上 大介, 坂本 竜司郎 座長 坂本 竜司郎(牧野フライス製作所)</p>	<p>【A. ラッピング・ポリシング・CMPの原理と応用(3)】 (林 偉民, 鈴木 恵友, 佐竹 うれら, 村田 順二) 座長 村田 順二(立命館大学)</p>	<p>【B. 先端加工計測技術(1)】 (水谷 康弘, 伊東 聡) 座長 伊東 聡(富山県立大学)</p>	<p>【N. 工作機械の高性能・高機能化・CAM】 (吉岡 勇人, 金子 順一, 猪狩 龍樹, 齋藤 明徳) 座長 金子 順一(埼玉大学)</p>	
9:00	A25 プリント配線板のドリリング技術開発 穴位置精度データの解析と改善方法の提案 ○星幸義, 寺井皓(ユニオンツール)	B25 Swayラップ盤の開発に関する基礎研究 ○上原祐郎, 諏訪部仁, 石川憲一(金沢工業大学)	C25 顕微Ramanイメージングによる砥石作業面状態観測 第1報: 半導体研削用砥石作業面のRamanイメージング計測特性と物体識別 ○田沢諒平, 田口稜, 小貫哲平, 尾島裕隆, 清水淳, 周立波(茨城大学)	D25 JISB8336-6 BK1, BK2に準拠した5軸マシニングセンタの性能評価 围分政樹, 対比地健, 浅香咲弥, 小豆畑知矢, 齋藤明徳(日本大学), 小野裕道(福島県ハイテクプラザ)	9:00
9:20	A26 ボールエンドミル先端部が創成する加工面の調査と加工面性状を向上させる工具形状の開発 ○渡邊昌英, 渡邊英人, 吉村翔太(ユニオンツール)	B26 スラリー精密吐出による研磨パッドとウエハの接触状態の制御 ○中野佑弥, 吉富健一郎, 宇根篤輔(防衛大学校)	C26 顕微ラマン断層イメージングによるワイドバンドギャップ半導体ウエハ加工変質層観測(第2報)-4H-SiCウエハ加工変質層の観測と評価- ○茂垣有亮, 柴 教一郎, 小貫哲平, 尾島裕隆, 清水淳, 周立波(茨城大学)	D26 長尺内面研削スピンドルの開発に関する研究 第13報: 単一軸型スピンドルと支持筒型スピンドルの静剛性についての理論的検討 ○安達和彦(中部大学), 大久保元博(大久保精工), 高橋宏美(ジェイテクトグライディングシステム)	9:20
9:40	A27 単結晶ダイヤモンド製切削工具の品質の光学的評価 ○鈴木浩文, 古木辰也(中部大学), 粟木久光(愛媛大学), 森泉利之(城南ダイヤモンド工業)	B27 紫外線を援用した電気化学機械研磨によるGaNの高効率スラリーレス加工法の開発 ○大西雄也, 陶通, 孫栄現, 大久保雄司, 山村和也(大阪大学)	C27 顕微ラマン断層イメージングによる狭バンドギャップ半導体ウエハ加工変質層観測 -シリサイド系半導体ウエハの計測特性- ○渡邊和馬, 小貫哲平, 輪殿治彦(茨城大学)	D27 液浸冷却によるモータのダイレクト冷却システムの効果検証 ○内山元喜, 橋本有世(神奈川大学), 中尾陽一(神奈川大学)	9:40
10:00	A28 高硬度金型材料を対象とした直彫りミリング加工に関する研究 オイルミスト供給の違いが加工特性に及ぼす影響 ○南出武尊(金沢工業大学), 山根健史(ADEKA), 加藤秀治(金沢工業大学), 古野真弘(MOLDINO)	B28 CMPにおけるSiC 試料の表面観察 ○山田遼太, 池野順一, 山田洋平(埼玉大学)	C28 無線式砥石軸振動計測装置を用いた研削加工の異常検知に関する研究 ○米澤心貴, 加藤和弥, 渡部朋哉, 植松瑞貴, 渡邊康太(湘南工科大学), 菊地清幸, 伊藤新樹(黒田精工)	D28 サーボモータの機械学習による熱変位予測 ○佐藤豪, 八木風成(神奈川大学), 中尾陽一(神奈川大学)	10:00
10:20	A29 旋削加工における切りくず制御に関する基礎的研究 ○木島竜, 神雅彦(日本工科大学)	<p>【C. 超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用】 (山口 桂司, 澤 武一, 佐藤 隆之介, 松浦 寛, 山口 智実) 座長 佐藤 隆之介(宇都宮大学)</p>	<p>【B. 先端加工計測技術(2)】 (水谷 康弘, 伊東 聡) 座長 加藤 和弥(湘南工科大学)</p>	<p>【一般セッション】 【P. 超精密加工装置の開発と超精密加工技術】 (森田 晋也, 山村 和也, 古城 直道, 古木 辰也, 福田 将彦) 座長 山村 和也(大阪大学)</p>	10:20
10:40	<p>【E. ナノ精密・ELID加工】 (片平 和俊, 江面 篤志, 稲澤 勝史) 座長 江面 篤志(三条市立大学)</p>	B30 LN結晶の鏡面加工に使用可能な熱可塑性樹脂軸付き砥石の開発と性能評価 ○菅井悠人, 菅原 颯斗, 小幡望美, 松浦寛(東北学院大学)	C30 ヘリカル補間運動を用いたスレッドミルによる微小雌ねじ加工に関する研究 ○松野下純, 常藤美海, 松井翔太(木更津工業高専), 廣垣俊樹(同志社大学), 松田亮(山本金属製作所)	D30 Watershedアルゴリズムを用いた特徴点抽出に基づく砥石表面の3次元形状計測 ○佐々木航, 内田雄基, 尾島裕隆, 周立波, 小貫哲平, 清水淳, 金子和輝(茨城大学)	10:40
11:00	A31 ファインバブルを含有した研削液を用いた光学ガラスの研削加工における吸気量の影響 ○小池宏信, 近藤弘康, 山下健介(栃木県産業技術センター), 稲澤勝史(栃木県産業労働観光部), 江面篤志(三条市立大学)	B31 不織布砥石を用いた半導体材料表面の研削加工に関する研究 ○佐々木拓巳, 南條健人, 塔ヶ崎巧, 松浦寛(東北学院大学), 國枝泰博(東北大学), 相澤崇史(産業技術総合研究所)	C31 近赤外光源を用いた斜入射干渉計の欠測範囲の低減 ○伊東聡, 山岸巧, 松本公久, 松本賢太, 神谷和秀(富山県立大学)	D31 ガラス内銀析出現象における電流密度の影響 ○目黒広大, 川村拓史(長岡技術科学大学), 松坂社太(千葉大学), 原圭祐(一関工業高専), 磯部浩己(長岡技術科学大学)	11:00
11:20	A32 潤滑性を付与した導電性ラバーボンド砥石を用いたELID研削特性 ○稲澤勝史(東京電機大学), 江面篤志(三条市立大学), 田村昌一(東京電機大学), 大森整(理化学研究所), 伊藤伸英(茨城大学)	B32 スクリーン印刷によるCeO ₂ 複合ポリイミド砥石の積層及び成形条件の検討 ○六平太陽, 大沢未歩, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由(秋田県立大学)	C32 主軸回転時に測定可能な工具ホルダ把持ひずみ分布測定装置の開発 ○田中秀岳, 小林康記(上智大学)	D32 橋脚振動切削による光学部品の加工検討(第3報) ○長坂圭祐, 福田将彦(芝浦機械)	11:20
11:40	A33 膨潤量の異なる樹脂を用いた3Dプリンタ砥石がPMMA研削加工に及ぼす影響 ○稲澤勝史(東京電機大学), 吉田凛太郎(茨城大学), 江面篤志(三条市立大学), 田村昌一(東京電機大学), 大森整(理化学研究所), 伊藤伸英(茨城大学)	B33 溶媒キャスト法で作製したCNT複合フェノールボンド砥石のロータリー平面研削による性能評価 ○立木良芽, 岩上素人, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由, 伊藤亮(秋田県立大学)	C33 深層学習を用いたシングルビクセルイメージングによる推定不確かさの評価 ○片岡将磨, 水谷康弘, 上野原勇, 高谷裕浩(大阪大学)	D33 光学ガラスの表面下損傷の可視化(第5報) ○井上寛人, 倉上龍太郎, 古城直道, 山口智実, 廣岡大祐(関西大学), 角田勝俊, 棚田憲一(ミスホ)	11:40
12:00	***** 休憩 *****				12:00

13:00		13:00
13:20	我が社の新技術発表会 (A～D室)	13:20
13:40		13:40
14:00	***** 休 憩 *****	14:00
14:50	地区部会周年講演 および 特別講演会(A室)	14:50
16:20	***** 休 憩 *****	16:20
16:30	活動報告会 贈賞式 (A室)	16:30
17:30	***** 移 動 *****	17:30
18:00	懇親会(ホテルニューオータニ長岡)	18:00
20:00		20:00

2024年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2024)セッションプログラム

【第3日目:8月28日(水)】(セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	
	<p>【L. 切断・削断加工】 (諏訪部 仁, 松坂 壮太, 浅井 義之, 坂本 智) 座長 浅井 義之(三星ダイヤモンド工業)</p>	<p>【I. 超音波・振動援用加工(1)】 (神 雅彦, 今井 健一郎, 磯部 浩己, 原 圭祐) 座長 磯部 浩己(長岡技術科学大学)</p>	<p>【T. 付加加工】 (阿部 壮志, 山内 友貴, 福山 遼) 座長 阿部 壮志(埼玉大学)</p>	<p>【X. 表面改質技術(1)】 (鈴木 庸久, 原田 泰典, 中村 守正, 田中 一平) 座長 中村 守正(同志社大学), 原田 泰典(兵庫県立大学)</p>	
9:00	A35 ガラス内亀裂伸張現象によるナノ流路デバイスの作製 ○金谷颯, 伊東翔, 松坂壮太, 比田井洋史(千葉大学)	B35 超音波加工によって金属加工面に形成された加工変質層の厚さの評価 ○森田陽亮(奈良県産業振興総合センター)	C35 3Dプリンタを用いたビトリファイド砥石の作製と加工特性の評価 ○阿部 尊, 高橋七宝, 井山徹郎(長岡工業高専)	D35 イオンビーム照射がTiN薄膜の結晶成長と超硬合金基板との界面に及ぼす影響 ○影山和裕, 佐藤颯哉, 鈴木庸久, 藤井達也, 野村光由(秋田県立大学), 関根崇, 菅原靖, 杉山重彰(秋田県産業技術センター)	9:00
9:20	A36 被削材の材料特性がワイヤ工具との接触状態におよぼす影響 ○蘇一銘, 坂本智(横浜国立大学), 山口顕司(米子工業高専)	B36 超音波振動による摩擦制御に関する研究 ○JankreefRudeemas, ThippakmasSutans(King Mongkut's University of Technology Thonburi), 神雅彦(日本工業大学)	C36 スケッチからCADモデル作成とその3Dプリンティングへの応用 ○リュウエウ, 裡しやりふ(北見工業大学)	D36 温度変調ダイヤモンド膜のトライボロジー特性評価 ○大西亮多, 田中一平, 川口夏樹, 原田泰典(兵庫県立大学)	9:20
9:40	A37 スラリー中の分散剤と切削がマルチワイヤソーの加工特性に与える影響 ○岩佐康生, 諏訪部仁, 石川憲一(金沢工業大学)	B37 精密超音波研磨に関する基礎的研究 第9報: 20kHz超音波振動主軸の試作および研磨特性 ○中野碧, 神雅彦(日本工業大学), 金井秀生(カナリエンジニアリング)	C37 3Dプリンティング技術によって作製された複雑形状の正確度検証システムの開発 ○岡本卓也, 裡しやりふ(北見工業大学)	D37 高分子電解質を用いた固相電解酸化によるTi表面の改質 ○早川晋平, 村田順二(立命館大学)	9:40
10:00	<p>【Q. 磁界・電界磁粒制御による次世代加工技術】 (川久保 英樹, 鄒 鶴華, 久住 孝幸, 野村 光由) 座長 野村 光由(秋田県立大学), 川久保 英樹(信州大学)</p>	B38 超精密超音波振動研磨に関する基礎的研究 第10報: 各種被削材に対する研磨特性 ○神雅彦, 春田豊, 中野碧(日本工業大学), 金井秀生(カナリエンジニアリング)	C38 シールドガス管理に基づくワイヤークAMの造形特性に関する研究 ○鳥越海治朗, 山口 貴, 古本達明, 橋本洋平, 小谷野智広(金沢大学)	D38 DLC膜のラマンスペクトルに対するピークフィッティング法の検討 ○辻将大, 中村守正, 松岡敬(同志社大学)	10:00
10:20	A39 刃先研磨処理に対する凝着摩耗の振る舞い ○長屋圭, 田中浩, 清水拓海(愛知工業大学)	<p>【I. 超音波・振動援用加工(2)】 (神 雅彦, 今井 健一郎, 磯部 浩己, 原 圭祐) 座長 今井 健一郎(神奈川工科大学)</p>	C39 PBF-LB/Mで得られた造形物の変形抑制に向けた造形戦略 ○古本達明, 川崎海(金沢大学), 江面篤志(三奈市立大学), 吉田光慶, 田中隆三(松浦機械製作所)	<p>【X. 表面改質技術(2)】 (鈴木 庸久, 原田 泰典, 中村 守正, 田中 一平) 座長 田中 一平(兵庫県立大学)</p>	10:20
10:40	A40 電解酸化水を用いた砥粒レス磁気援用内面加工 —加工面と粒子の状態— ○川久保英樹, 佐藤運海(信州大学)	B40 超音波振動切削における被削材内部せん断ひずみ速度分布の可視化 ○高谷祐真(長岡技術科学大学), 辻尚史(秋田工業高専), 原圭祐(一関工業高専), 川村拓史, 磯部浩己(長岡技術科学大学)	<p>【K. 難削材・新素材の加工と応用】 (静 弘生, 北嶋 孝之, 田中 隆太郎, 清瀬 啓) 座長 北嶋 孝之(防衛大学校)</p>	D40 ショットピーニング面の残留応力深さ分布の非破壊推定法 ○岡野俊之, 村田一夫(オカノプラスチック), 小栗泰造, 田中努(大阪産業技術研究所), 廣垣俊樹, 中川正夫, 青山栄一(同志社大学)	10:40
11:00	A41 磁気混合流体(MCF)研磨における精密仕上げ—MCFスラリーの特性が研磨性能に及ぼす効果— 野村光由, 〇後藤弘樹, 浅間皓貴, 藤井達也, 鈴木庸久(秋田県立大学)	B41 センタースルー軸付き砥石による石英ガラスの穿孔加工への工具超音波振動の効果 ○田村謙太郎, 川村拓史(長岡技術科学大学), 原圭祐(一関工業高専), 磯部浩己(長岡技術科学大学)	C41 ガラス—樹脂—一体成型部材の穴あけ加工における加工開始面が切削抵抗に与える影響 ○小出彪威, 松岡慶太郎, 井山徹郎(長岡工業高専)	D41 真空浸炭処理された切欠き材の回転削げ磨き限度に及ぼすショットピーニングおよびブラスト研磨加工の影響 ○辻俊哉, 小林祐次, 谷口隼人(新東工業), 政木清孝(埼玉工業大学)	11:00
11:20	A42 電界磁粒制御技術を用いた新たな切断加工技術(第3報) ○久住孝幸, 越後谷正見(秋田県産業技術センター), 池田洋, 細川遥花(秋田工業高専)	B42 超音波振動切削により創成された表面テクスチャの塑性ひずみ分布 ○林大翔(長岡技術科学大学), 田口恭輔(八戸工業高専), 高島孝太(長岡技術科学大学), 辻尚史(秋田工業高専), 原圭祐(一関工業高専), 川村拓史, 磯部浩己(長岡技術科学大学)	C42 複合材料の加工を目的とした弾性を有するメタルボンド砥石の提案と評価 ○伊藤惠太, 中林蒼汰, 井山徹郎(長岡工業高専), 高田篤, 大橋恭介, 木村悠生(ナノテム)	D42 粒子衝突を応用したMg合金の表面改質 ○保坂利晃, 原田泰典(兵庫県立大学)	11:20
11:40	A43 電磁場印加型研磨ホイールの加工特性と工具に作用するトルクの関係 ○山本久嗣, 西田均, 茶木智勝(富山高専)	B43 超音波振動切削時に創成される表面テクスチャの配列制御システムの開発 第4報: プラト—構造表面の高速創成 ○高島孝太(長岡技術科学大学), 柳澤憲史(長野工業高専), 櫻田陽, 辻尚史(秋田工業高専), 川村拓史(長岡技術科学大学), 原圭祐(一関工業高専), 磯部浩己(長岡技術科学大学)	C43 マルチマテリアルの切削加工に関する研究 ○川塚宣隆, 山岸英樹, 柿内茂樹(富山県産業技術研究開発センター), 高野登(富山大学)		11:40
12:00	***** 休 憩 *****				12:00

13:00	奨励賞受賞記念講演 (A室)			13:00	
13:40	***** 休憩 *****			13:40	
	【O. 加工のデータサイエンス】 (児玉 結幸, 廣垣 俊樹, 坂口 彰浩, 小島 大) 座長 児玉 結幸(岡山大学)	【I. 超音波・振動援用加工(3)】 (神 雅彦, 今井 健一郎, 磯部 浩巳, 原 圭祐) 座長 神 雅彦(日本工業大学)	【V. トライボロジー】 (清水 淳, 宇佐美 初彦) 座長 宇佐美 初彦(名城大学), 清水 淳(茨城大学)	【X. 表面改質技術(9)】 (鈴木 庸久, 原田 泰典, 中村 守正, 田中 一平) 座長 鈴木 庸久(秋田県立大学)	
14:00	A51 プリント基板Cuダイレクトレーザビア加工の画像2色法温度モニタとその機械学習による品質予測 ○藤本拓人, 野渡颯真, 中川正夫, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学)	B51 超音波振動援用ドリル加工時における前加工法がバリ周辺金属結晶構造に及ぼす影響 ○田口恭輔(八戸工業高専), 原圭祐(一関工業高専), 吉原信人(岩手大学), 磯部浩巳(長岡技術科学大学), 水野雅裕(岩手大学)	C51 アルミニウムへのクロムめっき前処理として微粒子ピーニングが示す効果 ○飯島一輝, 佐藤秀明, 小玉脩平(東京都市大学), 音羽伸哉(中央製作所), 中田充彦(東伸化工), 亀山雄高(東京都市大学)	D51 ショットライニングによる難燃性マグネシウム合金の表面特性 保坂利晃, 杉原健太, ○原田泰典, 田中一平(兵庫県立大学)	14:00
14:20	A52 高速サンプリング無線式加速度センサによるターレット振動モニタとサーボ情報を統合した旋削加工の診断 ○野崎友裕, 山本隆将, 松田亮, 新堂正俊(山本金属製作所), 中川正夫, 廣垣俊樹(同志社大学)	B52 Ti ₂ AlCセラミックスの超音波切削特性の評価 ○原圭祐(一関工業高専), 山口直也(福島工業高専), 高島孝太(長岡技術科学大学), 辻尚史(秋田工業高専), 川村拓史, 南口誠, 磯部浩巳(長岡技術科学大学)	C52 すべり要素を適用したアルミニウムの局所静水圧援用切削の実験とシミュレーション ○清水淳, 山本武幸, 金子和暉, 小貫哲平, 尾島裕隆, 周立波(茨城大学)	D52 AlおよびZnに対するPVD膜の耐凝着性におけるショットプラストの影響 ○後裕介(ウメトク), 田中一平, 原田泰典(兵庫県立大学), 南馬祐二, 荻巣高志(ウメトク)	14:20
14:40	A53 カオスの特徴を規範とする表面粗さのモデリングとシミュレーション ○嵐椋平, ゴーシュアंकシュクマール, 裡しゃりふ(北見工業大学)	B53 背分力方向の超音波振動切削の加工現象究明 第1報: 被削材内部応力分布の動的変化と工具逃げ角の関係 ○辻尚史(長岡技術科学大学), 秋田工業高専, 野島柚斗(長岡技術科学大学), 現, SMC, 高島孝太, 川村拓史(長岡技術科学大学), 原圭祐(一関工業高専), 磯部浩巳(長岡技術科学大学)	C53 振動援用切削による金属テスチャ表面の固体潤滑特性 ○國丹魁人, 清水淳, 山本武幸, 金子和暉, 小貫哲平, 尾島裕隆(茨城大学)	D53 トルエンを原料に用いたMVPIによる窒化炭素の合成 ○田中一平, 服部勇紀, 原田泰典(兵庫県立大学)	14:40
15:00	A54 工具摩耗データのオープン化とその応用に関する研究 ○任連詰, ゴーシュアंकシュクマール, 裡しゃりふ(北見工業大学)	【I. 超音波・振動援用加工(4)】 (神 雅彦, 今井 健一郎, 磯部 浩巳, 原 圭祐) 座長 原 圭祐(一関工業高等専門学校)	C54 衝撃粉末成形によるPTFE添加Mg基複合材料のしゅう動面におけるPTFE保護被膜形成に及ぼす荷重の影響 ○森島櫻礼, 松岡敬, 中村守正(同志社大学), 田中茂(熊本大学)	【H. 先進切削加工技術】 (田代 徹也, 杉原 達哉, 林 宏和) 座長 田代 徹也(大阪電気通信大学)	15:00
15:20	A55 可能性分布を用いた生産加工工程の最適化に関する研究 ○サイコウウ, 裡しゃりふ, ゴーシュアंकシュクマール(北見工業大学)	B55 フッ素ゴムの研削における超音波振動の援用が砥石作業面と被削面に及ぼす影響 ○藤本正和(足利大学), 藤崎仁菜, 出木浦卓斗, 山本遼太郎(近畿大学)	C55 凸型テスチャ面の摩擦摩耗特性に及ぼす加工プロセスの影響 ○宇佐美初彦(名城大学)	D55 アクリル製海中ソーラパネルのテスチャ加工に関する研究 第2報 テスチャ深さのフジッポ付着抑制効果について ○平尾蒼臣(神奈川大学), 鈴木浩文(中部大学), 松村清隆(北里大学), 滝田 好宏, 由井明紀(神奈川大学)	15:20
15:40		B56 4H-N型SiCウエハの超音波振動援用研削加工 ○今井健一郎(神奈川工科大学)		D56 天然竹筒材からのエンドミル加工の強制びり振動制御に基づくファイン竹繊維の抽出法 ○田中海翔, 北崎礼慈, 中原裕太郎, 中川正夫, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学), 野辺弘道(三藤機械製作所)	15:40
16:00		B57 超音波振動援用微細ギアスライピング加工 ○岩井学, 高野慎之助(富山県立大学), 岳義弘(超音波加工技術研究所), 平田保之(新居浜工業高専), 内田慎介(精電舎電子工業), ニノ宮進一(日本工業大学)		D57 オフラインティーチングに基づく大型産業用ロボットによる特異点での切削加工の研究 ○加藤大暉, 内野友裕, 関岡将天, 中川正夫, 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学)	16:00